

1. 適用範囲

1. Scope

1.1 内容

本規格は、0.6 mmピッチ基板対基板コネクタ フリー・ハイト・タイプの実装方法に関する必要条件について規定する。

1.1 Contents

This specification covers the requirements for mount of 0.6 mm Pitch Board-to-Board Connector Free Height Type.

Rev. A

114—5255

Application Specification

AMP FH 0.6mm Pitch Board-to-Board Connector

(Surface-Mount Technology)

2. 関連規格

108-5468 製品規格

501-5164 認定試験報告書

2. Related Specifications

108-5468 Product Specification

501-5164 Test Report

3. 各部の名称

3. Product Features

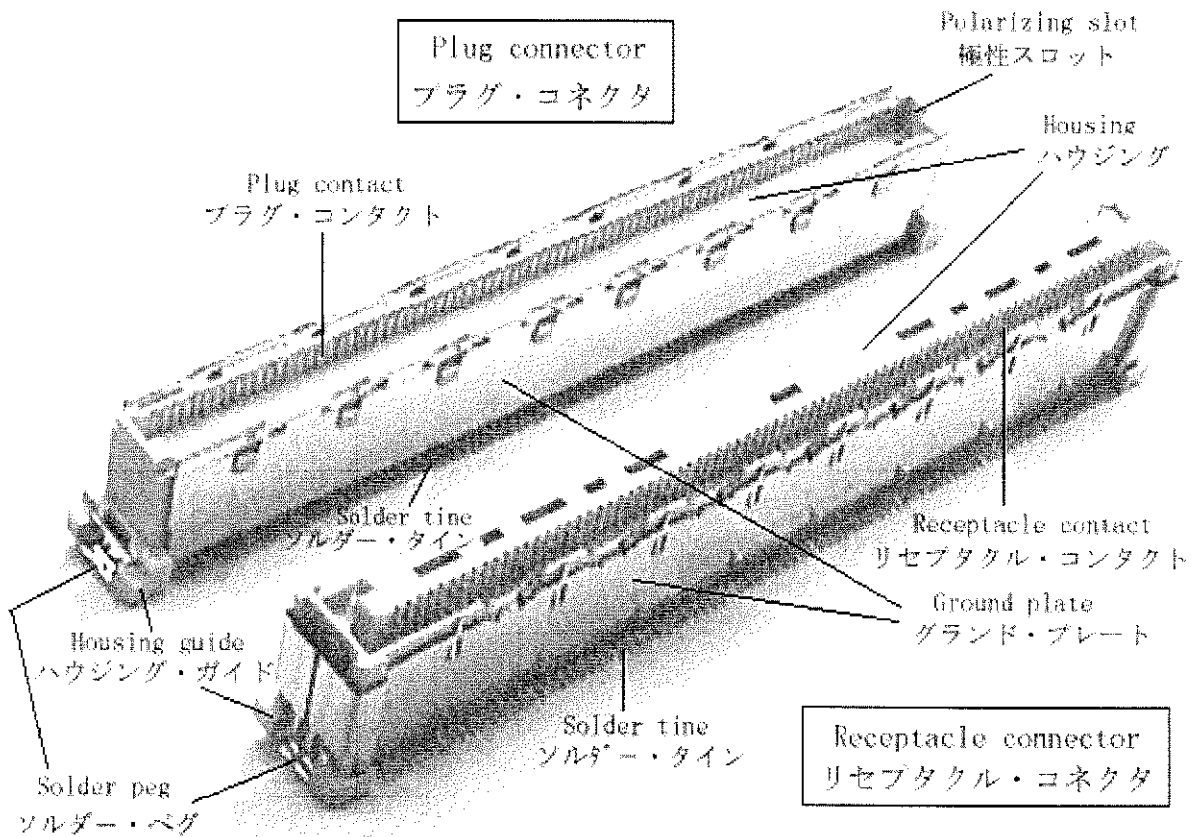


Fig. 1

要求事項

4. Requirments

4.1 保管

(A) 本コネクタの梱包方法は、エンボス・テープ、チューブ、ハード・トレーの3種類です。コネクタを保管する際は、ゴミ、埃等が入らないように梱包状態のまま、有毒ガス等がなく、且つ常温、常湿の環境下の保管を推奨します。(常温、常湿 ; 5~35℃, 45~75% RH)

(B) 作業途中で保管される際は、露出状態で放置しないようお願いします。

(C) 開封後の長期保管は避け、3ヶ月以内の使用を推奨します。

4.1 Storage

(A) This connector is packaged and shipped in an emboss tape, tube or hard tray. We recommend that the connector remain in the container to prevent contamination or dust, and that it is stored, keeping at normal temperatures, normal humidity and no poisonous gas.

(Normal temperatures and humidity : 5~35℃, 45~75% RH)

(B) If this connector is stored in the middle of operating, it should not remain naked.

(C) We recommend that this connector isn't stored for a long time after opening a package and that it is used within three months.

4.2 基板

材質はガラス・エポキシ材をご使用願います。

薄基板をご使用の際には、反りを防止する為、コネクタ嵌合時に裏面からサポートして下さい。

4.2 Printed Circuit Board

The pc board shall be glass epoxy. If you use a thin board, we recommend you to give support to it from reverse side in order to prevent a bow of board when mating.

4.3 基板レイアウト

カスタマー図面を参照下さい。

4.3 PC Board Layout

Please refer to customer drawing.

4.4 はんだ付け

(A) 推奨溶剤ペースト

1. 合金タイプは63Sn/37Pb又は60Sn/40Pbを使用願います。
2. フラックスは弱活性化ロジンフラックス (RMA TYPE) を使用して下さい。

(B) マスク

1. 推奨マスク厚 : 0.15~0.18mm
2. 推奨はんだボリウム及び開口部寸法例 (パッド1個当たり)

	Height (mm)	はんだボリウム (mm ³)	開口部寸法例(mm)	
			マスク厚 0.15t	マスク厚 0.18t
プラグコンタクト	4	0.088	0.25W×2.35L	0.25W×1.96L
	5~12	0.045	0.25W×1.19L	0.18W×0.99L
リセコンタクト	4	0.049	0.25W×1.31L	0.25W×1.09L
	8.12	0.044	0.25W×1.16L	0.25W×0.97L
溶剤ペースト		0.584	3.2W×1.22L	3.2W×1.01L

(C) リフロー条件

予備加熱 : 100~150℃ 60秒以上

加熱 : 210℃以上 30秒以下

ピーク温度 : 240℃以下

(D) 取り付け

コネクタのはんだタイン部を変形させず保持して、基板面と水平に取り付けられるように自動実装機の調整をお願い致します。又、はんだタインが基板パッドの中心にくるよう整列させて下さい。

(E) リペア

はんだゴテをご使用になる場合には、タイン部にコテ先が触れないように注意して下さい。

コテ先温度 : 300℃以下 作業時間 : 3秒以下

4.4 Solder Techniques

(A) Recommend Solder Paste

1. Alloy type shall be either 63Sn/37Pb or 60Sn/40Pb.
2. Flux shall be RMA type.

(B) Solder Mask

1. Recommended mask thickness : 0.15~0.18mm
2. Recommended solder volume and an example of aperture pad DIM. (per pad)

	Height (mm)	Solder volume (mm ³)	An example of aperture pad DIM.(mm)	
			Mask thickness : 0.15t	Mask thickness : 0.18t
Plug contact	4	0.088	0.25W×2.35L	0.25W×1.96L
	5~12	0.045	0.25W×1.19L	0.18W×0.99L
Receptacle contact	4	0.049	0.25W×1.31L	0.25W×1.09L
	8.12	0.044	0.25W×1.16L	0.25W×0.97L
Solder peg		0.584	3.2W×1.22L	3.2W×1.01L

(C) Reflow Condition

Preheat : 100~150°C 60 Sec. Min

Heat : 210°C Min 30 Sec. Max

Heat peak : 240°C Max

(D) Connector Placement

Please adjust the automatic mounter in such a way that it is set up at a surface level, keeping without deformation of the solder tine. Optimally, the connector solder tine should be aligned as centered on the PC board pads.

(E) Repair

If a soldering iron is used, full care must be taken not to contact the solder tine by tip of a soldering iron.

Recommended temperature of soldering iron : 300°C MAX.

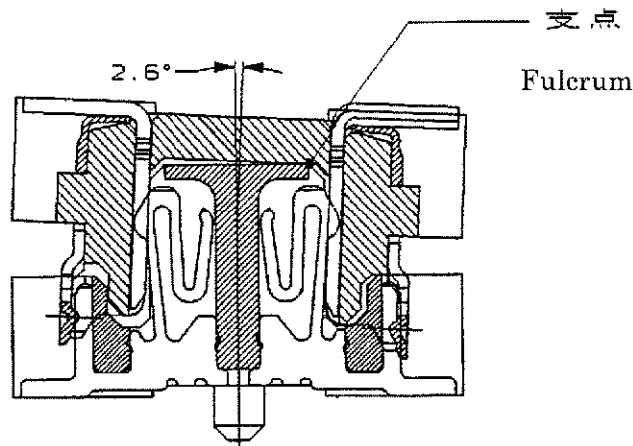
Operating time : 3sec. Max. per pad

4.6 嵌合角度

嵌合作業は、2.6° 以内にて行って下さい。

4.6 Mating angle

Please do mating work within 2.6 degrees.



改訂 LTR	改訂記録 REVISION RECORD	作成 DR	検閲 CHK	承認 APVD	年月日 DATE
0	制定 FJ00-1319-98	J. Tsuji	Y. Yamamoto	Y. Yamamoto	15-Jul-'01
A	改訂 FJ00-2726-01	J. Tsuji	<i>T. Sakai</i>	<i>Y. Yamamoto</i>	26-NOV-'01
		<i>y. tsuji</i>			